

## 千住金属工業

# エコソルダ ボール開発

千住金属工業は、スマートフォンや車載用の半導体実装用としてエコソルダボール「M770」を開発した。

スマートフォンやタブレットに代表されるモバイル機器には落下のリスクがあり、耐落下衝撃性に優れたソルダボールが必要。一方、ますます軽薄短小化する

るために耐熱疲労特性に優れたソルダボールが必要となる。従来、それぞれに適する材料を整えていたが、同時に満足できるはんだ材料としてM770を開発、製品化した。

同社は、Sn-Ag-Cu系の析出強化制御とプラズマアルファの添加元素による界面反応制御技術で、はんだと接合界面に化合物を

生成させるCu、Ni、Auなど各種基板表面処理材料に適する材料を開発し、相反する技術的課題を同時に満足させた。特に半導体実装で多用されるNi/Auメッキとの相性に優れている。

車載用途も、耐振動衝撃性と耐熱疲労性を同時に要求されることから各種用途への拡大に期待している。

千枚以上のCB証明書を発行しており、発行件数は世界シェアの20%という。

今回の認証機関および試験所としての認定範囲の拡大に伴い、今後は国内外の電気自動車、電気自動車関連製品メーカーの海外市場参入をさらに強力にサポートする方針だ。